

DSC-W350

SERVICE MANUAL

Ver. 1.0 2010.01



Photo: Silver

LEVEL 3

- US Model
- Canadian Model
- AEP Model
- UK Model
- E Model
- Australian Model
- Hong Kong Model
- Chinese Model
- Korea Model
- Argentine Model
- Brazilian Model
- Japanese Model
- Tourist Model

Check the SERVICE NOTE (LEVEL 2) before the service.

Revision History

Ver.	Date	History	Contents
1.0	2010.01	Official Release	—

DIGITAL STILL CAMERA

SONY®

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

Caution

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Dispose of used batteries according to the instructions.

SAFETY-RELATED COMPONENT WARNING!!

COMPONENTS IDENTIFIED BY MARK \triangle OR DOTTED LINE WITH MARK \triangle ON THE SCHEMATIC DIAGRAMS AND IN THE PARTS LIST ARE CRITICAL TO SAFE OPERATION. REPLACE THESE COMPONENTS WITH SONY PARTS WHOSE PART NUMBERS APPEAR AS SHOWN IN THIS MANUAL OR IN SUPPLEMENTS PUBLISHED BY SONY.

ATTENTION AU COMPOSANT AYANT RAPPORT À LA SÉCURITÉ!

LES COMPOSANTS IDENTIFIÉS PAR UNE MARQUE \triangle SUR LES DIAGRAMMES SCHÉMATIQUES ET LA LISTE DES PIÈCES SONT CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT. NE REMPLACER CES COMPOSANTS QUE PAR DES PIÈCES SONY DONT LES NUMÉROS SONT DONNÉS DANS CE MANUEL OU DANS LES SUPPLÉMENTS PUBLIÉS PAR SONY.

SAFETY CHECK-OUT

After correcting the original service problem, perform the following safety checks before releasing the set to the customer.

1. Check the area of your repair for unsoldered or poorly-soldered connections. Check the entire board surface for solder splashes and bridges.
2. Check the interboard wiring to ensure that no wires are “pinched” or contact high-wattage resistors.
3. Look for unauthorized replacement parts, particularly transistors, that were installed during a previous repair. Point them out to the customer and recommend their replacement.
4. Look for parts which, through functioning, show obvious signs of deterioration. Point them out to the customer and recommend their replacement.
5. Check the B+ voltage to see it is at the values specified.
6. Flexible Circuit Board Repairing
 - Keep the temperature of the soldering iron around 270°C during repairing.
 - Do not touch the soldering iron on the same conductor of the circuit board (within 3 times).
 - Be careful not to apply force on the conductor when soldering or unsoldering.

Unleaded solder

Boards requiring use of unleaded solder are printed with the leadfree mark (LF) indicating the solder contains no lead.
(Caution: Some printed circuit boards may not come printed with the lead free mark due to their particular size.)



Unleaded solder has the following characteristics.

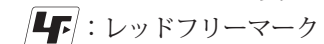
- Unleaded solder melts at a temperature about 40°C higher than ordinary solder.
Ordinary soldering irons can be used but the iron tip has to be applied to the solder joint for a slightly longer time.
Soldering irons using a temperature regulator should be set to about 350°C.
Caution: The printed pattern (copper foil) may peel away if the heated tip is applied for too long, so be careful!
- Strong viscosity
Unleaded solder is more viscous (sticky, less prone to flow) than ordinary solder so use caution not to let solder bridges occur such as on IC pins, etc.
- Usable with ordinary solder
It is best to use only unleaded solder but unleaded solder may also be added to ordinary solder.

注意

電池の交換は、正しく行わないと破裂する恐れがあります。電池を交換する場合には必ず同じ型名の電池又は同等品と交換してください。使用済み電池は、取扱指示に従って処分してください。

サービス、点検時には次のことにご注意ください。

1. 注意事項をお守りください。
サービスのとき特に注意を要する個所については、キャビネット、シャーシ、部品などにラベルや捺印で注意事項を表示しています。これらの注意書き及び取扱説明書等の注意事項を必ずお守り下さい。
2. 指定部品のご使用を
セットの部品は難燃性や耐電圧など安全上の特性を持ったものとなっています。従って交換部品は、使用されていたものと同じ特性の部品を使用して下さい。特に回路図、部品表に \triangle 印で指定されている安全上重要な部品は必ず指定のものをご使用下さい。
3. 部品の取付けや配線の引きまわしはもとどおりに安全上、チューブやテープなどの絶縁材料を使用したり、プリント基板から浮かして取付けた部品がありません。また内部配線は引きまわしやクランパによって発熱部品や高圧部品に接近しないよう配慮されていますので、これらは必ずもとどおりにして下さい。
4. サービス後は安全点検を
サービスのために取外したネジ、部品、配線がもとどおりになっているか、またサービスした個所の周辺を劣化させてしまったところがないかなどを点検し、安全性が確保されていることを確認して下さい。
5. チップ部品交換時の注意
 - 取外した部品は再使用しないで下さい。
 - タンタルコンデンサのマイナス側は熱に弱いため交換時は注意して下さい。
6. フレキシブルプリント基板の取扱いについて
 - コテ先温度を270°C前後にして行なって下さい。
 - 同一パターンに何度もコテ先を当てないで下さい。(3回以内)
 - パターンに力が加わらないよう注意して下さい。
7. 無鉛半田について
無鉛半田を使用している基板には、無鉛(Lead Free)を意味するレッドフリーマークがプリントされています。(注意: 基板サイズによっては、無鉛半田を使用しているレッドフリーマークがプリントされていないものがあります)



無鉛半田には、以下の特性があります。

- 融点が従来の半田よりも約40°C高い。
従来の半田こてをそのまま使用することは可能ですが、少し長めにこてを当てる必要があります。温度調節機能のついた半田こてを使用する場合、約350°Cに設定して下さい。
注意: 半田こてを長く当てすぎると、基板のパターン(銅箔)がはがれてしまうことがありますので、注意して下さい。
- 粘性が強い
従来の半田よりも粘性が強いため、IC端子などが半田ブリッジしないように注意して下さい。
- 従来の半田と混ぜて使用可能
無鉛半田には無鉛半田を追加するのが最適ですが、従来の半田を追加しても構いません。

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description						
* C419	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V	* CN705	1-821-500-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 45P	Q302	8-729-053-58	TRANSISTOR	RN1904FE (TPLR3)	* R414	1-245-671-11	METAL CHIP	39K	0.5%	1/20W		
C447	1-127-772-81	CERAMIC CHIP	0.033uF	10%	10V	* CN705	1-821-500-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 45P	Q304	6-550-119-01	TRANSISTOR	DTC144EMFS6T2L	R415	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W		
C448	1-127-772-81	CERAMIC CHIP	0.033uF	10%	10V			< DIODE >	Q402	6-550-240-01	TRANSISTOR	DTA114TMFS6T2L	R416	1-240-806-11	METAL CHIP	8.2K	0.5%	1/20W		
C451	1-127-772-81	CERAMIC CHIP	0.033uF	10%	10V				Q1000	6-550-119-01	TRANSISTOR	DTC144EMFS6T2L	R417	1-240-820-11	METAL CHIP	33K	0.5%	1/20W		
C452	1-127-772-81	CERAMIC CHIP	0.033uF	10%	10V				* Q1001	6-552-029-01	TRANSISTOR	MCH3377-S-TL-E	* R419	1-245-671-11	METAL CHIP	39K	0.5%	1/20W		
C453	1-114-411-21	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	6.3V	* D001	6-502-950-01	DIODE RB550VA-30TR			< RESISTOR >		R423	1-240-810-11	METAL CHIP	12K	0.5%	1/20W		
C454	1-114-411-21	CERAMIC CHIP	0.33uF	10%	6.3V	D004	8-719-073-35	DIODE RB551V-30TE-17	R002	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W	* R424	1-248-350-11	RES, METAL FILM	1.5 (2012)		
C456	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	D005	8-719-073-35	DIODE RB551V-30TE-17	R007	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W	R425	1-240-689-91	METAL CHIP	330	5%	1/20W
C457	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	D006	8-719-073-35	DIODE RB551V-30TE-17	R011	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W	R426	1-240-714-91	METAL CHIP	47K	5%	1/20W
C458	1-112-717-91	CERAMIC CHIP	1uF	10%	6.3V	D301	6-501-106-01	DIODE 1SS387CT (TL3SONY)	R013	1-240-736-11	METAL CHIP	10	0.5%	1/20W	R430	1-240-688-91	METAL CHIP	270	5%	1/20W
C504	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	D701	8-719-056-23	DIODE MA2S111-(K8).SO	R014	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W	R435	1-208-888-81	METAL CHIP	1.1K	0.5%	1/16W
C505	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V	D702	6-501-216-01	DIODE CL-271HR-C-TS	R020	1-240-830-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/20W	R436	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
C506	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V	D703	8-719-069-29	DIODE RB520S-30FJTE61	R027	1-246-079-91	METAL CHIP	10M	5%	1/20W	R450	1-245-601-11	METAL CHIP	470K	0.5%	1/20W
* C507	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V	* D711	6-502-988-01	DIODE RB480Y-40T2R	R029	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W	R451	1-245-601-11	METAL CHIP	470K	0.5%	1/20W
* C508	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	D713	8-719-421-71	DIODE MA132WA	R201	1-240-707-91	METAL CHIP	10K	5%	1/20W	R456	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
C509	1-107-819-11	CERAMIC CHIP	0.022uF	10%	16V	* D1000	6-502-629-01	DIODE 1SS420 (TL3SONY.F)	R203	1-240-674-91	METAL CHIP	15	5%	1/20W	R457	1-240-808-11	METAL CHIP	10K	0.5%	1/20W
C510	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V			< FUSE >	R204	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W	R465	1-240-700-91	METAL CHIP	2.7K	5%	1/20W
C511	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	6.3V	△* F001	1-576-415-31	FUSE, MICRO (1608) (2A/32V)	R209	1-240-678-91	METAL CHIP	33	5%	1/20W	R466	1-240-700-91	METAL CHIP	2.7K	5%	1/20W
C512	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V	△* F002	1-576-843-31	FUSE, MICRO (1608) (0.8A/32V)	R220	1-240-748-91	METAL CHIP	33	0.5%	1/20W	R514	1-240-713-91	METAL CHIP	33K	5%	1/20W
C513	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V	△* F003	1-576-842-31	FUSE, MICRO (1608) (0.63A/32V)	R225	1-240-780-11	METAL CHIP	680	0.5%	1/20W	R515	1-216-807-11	METAL CHIP	68	5%	1/10W
C514	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V			< FERRITE BEAD >	R226	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W	R517	1-240-693-91	METAL CHIP	680	5%	1/20W
C515	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V	* FB201	1-481-250-11	INDUCTOR, FERRITE BEAD (1005)	R242	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W	R518	1-240-693-91	METAL CHIP	680	5%	1/20W
C517	1-100-567-81	CERAMIC CHIP	0.01uF	10%	25V	FB202	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R243	1-240-703-91	METAL CHIP	4.7K	5%	1/20W	R519	1-240-697-91	METAL CHIP	1.5K	5%	1/20W
C518	1-165-989-11	CERAMIC CHIP	10uF	10%	6.3V	FB301	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R244	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W	R701	1-240-687-91	METAL CHIP	220	5%	1/20W
C519	1-165-908-11	CERAMIC CHIP	1uF	10%	10V	FB302	1-400-331-11	FERRITE, EMI (SMD) (1005)	R261	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W	R703	1-694-535-91	SHORT CHIP	0		
C520	1-100-415-91	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V			< IC >	R262	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W	R737	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
C521	1-100-415-91	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V	* IC001	6-713-896-01	IC AN30230A-VB	R263	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W	R920	1-240-707-91	METAL CHIP	10K	5%	1/20W
C523	1-100-415-91	CERAMIC CHIP	0.47uF	10%	6.3V	IC201	(Not supplied)	IC APX1G1G02A	R264	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W	R929	1-240-830-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/20W
C524	1-100-965-91	CERAMIC CHIP	0.047uF	10%	6.3V	(IC201 is supplied included in SY-242 complete board (SERVICE).)			R271	1-240-824-91	METAL CHIP	56K	0.5%	1/20W	R940	1-240-695-91	METAL CHIP	1K	5%	1/20W
* C701	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V	* IC203	6-710-919-01	IC ICS620AN-29LFT	R272	1-240-830-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/20W	R941	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W
* C702	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V	* IC204	6-714-929-01	IC uPD79F0107FC-401-2N1-E2-A	R273	1-240-824-91	METAL CHIP	56K	0.5%	1/20W	R986	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
C712	1-165-884-11	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	* IC301	6-714-381-01	IC ADDI9003BBCZRL	R274	1-240-830-11	METAL CHIP	100K	0.5%	1/20W	R987	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
* C713	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	* IC302	8-753-327-70	IC CXA3841UR-T9	* R275	1-240-792-91	METAL CHIP	2.2K	0.5%	1/20W	R989	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
* C717	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	* IC303	6-714-939-01	IC RP102K311D-TR	* R276	1-240-792-91	METAL CHIP	2.2K	0.5%	1/20W	R990	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
* C721	1-112-692-11	CERAMIC CHIP	1000p	5%	50V	* IC401	6-713-274-01	IC R2J30502LG	R284	1-208-943-11	METAL CHIP	220K	0.5%	1/16W	R991	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W
* C725	1-112-746-11	CERAMIC CHIP	4.7uF	10%	6.3V	* IC403	6-708-444-01	IC R1114Q281D-TR-FA	* R285	1-240-766-11	METAL CHIP	180	0.5%	1/20W	R999	1-240-685-91	METAL CHIP	150	5%	1/20W
C727	1-100-742-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	10V	* IC501	6-713-733-01	IC BD7112GW-E2	R286	1-240-766-11	METAL CHIP	180	0.5%	1/20W	R1000	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W
C728	1-112-300-91	CERAMIC CHIP	47uF	10%	10V			< COIL >	R287	1-240-766-11	METAL CHIP	180	0.5%	1/20W	R1001	1-240-699-91	METAL CHIP	2.2K	5%	1/20W
C729	1-100-743-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V	L001	1-481-036-11	INDUCTOR	R296	1-208-943-11	METAL CHIP	220K	0.5%	1/16W	R1002	1-240-691-91	METAL CHIP	470	5%	1/20W
C730	1-100-670-11	CERAMIC CHIP	47uF	20%	16V	L002	1-481-036-11	INDUCTOR	R297	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W	R1005	1-218-965-11	METAL CHIP	10K	5%	1/16W
C731	1-100-671-11	CERAMIC CHIP	47uF	20%	25V	L003	1-481-036-11	INDUCTOR	R298	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W			< COMPOSITION CIRCUIT BLOCK >			
C732	1-100-743-91	CERAMIC CHIP	2.2uF	20%	16V	L004	1-481-036-11	INDUCTOR	R302	1-218-985-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W	RB201	1-234-378-21	RES, NETWORK	10K (1005X4)		
C733	1-100-671-11	CERAMIC CHIP	47uF	20%	25V	L005	1-481-036-11	INDUCTOR	R303	1-218-979-11	METAL CHIP	150K	5%	1/16W			< SENSOR >			
C735	1-165-884-11	CERAMIC CHIP	2.2uF	10%	6.3V	L006	1-481-036-11	INDUCTOR	R304	1-208-941-11	METAL CHIP	180K	0.5%	1/16W	SE401	8-826-000-81	GYRO SENSOR	GSU-S362A/N-S (PITCH/YAW)		
C737	1-100-670-11	CERAMIC CHIP	47uF	20%	16V	L007	1-457-696-11	INDUCTOR	R305	1-208-907-11	METAL CHIP	6.8K	0.5%	1/16W			< THERMISTOR >			
C1002	1-100-539-91	TANTAL, CHIP	47uF	20%	6.3V	L301	1-400-678-11	INDUCTOR	R307	1-240-729-91	METAL CHIP	1M	5%	1/20W	TH201	1-805-194-21	THERMISTOR, NTC (SMD)			
* C1003	1-112-716-11	CERAMIC CHIP	0.1uF	10%	6.3V	L302	1-400-678-11	INDUCTOR	R308	1-218-978-11	METAL CHIP	1200K	5%	1/16W			< VIBRATOR >			
		< CONNECTOR >				L702	1-400-935-11	INDUCTOR, CHIP	R309	1-218-985-11	METAL CHIP	470K	5%	1/16W						
* CN301	1-821-500-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 45P						< TRANSISTOR >	R310	1-218-979-11	METAL CHIP	150K	5%	1/16W						
* CN301	1-821-500-11	CONNECTOR, FPC (ZIF) 45P				* Q001	6-552-065-01	TRANSISTOR	R311	1-240-718-91	METAL CHIP	100K	5%	1/20W						
CN402	1-821-032-81	CONNECTOR, FPC (ZIF) 35P				Q002	6-551-630-01	TRANSISTOR	R404	1-240-683-91	METAL CHIP	100	5%	1/20W						
CN402	1-822-925-61	CONNECTOR, FPC (ZIF) 35P				Q004	6-550-789-01	TRANSISTOR	R408	1-240-788-91	METAL CHIP	1.5K	0.5%	1/20W						
* CN701	1-822-768-21	CONNECTOR, FPC (ZIF) 25P				Q005	6-552-211-01	TRANSISTOR	R409	1-240-788-91										

6. SCHEMATIC DIAGRAMS AND PRINTED WIRING BOARDS

- ENGLISH -

THIS NOTE IS COMMON FOR SCHEMATIC DIAGRAMS AND PRINTED WIRING BOARDS.
(In addition to this, the necessary note is printed in each block.)

For Schematic Diagrams

- All capacitors are in μF unless otherwise noted. pF : μF . 50 V or less are not indicated except for electrolytics and tantalums.
- Chip resistors are 1/10 W unless otherwise noted. $\text{k}\Omega=1000 \Omega$, $\text{M}\Omega=1000 \text{k}\Omega$.
- Caution when replacing chip parts.
New parts must be attached after removal of chip.
Be careful not to heat the minus side of tantalum capacitor, Because it is damaged by the heat.
- Some chip part will be indicated as follows.

Example	C541 22U TA A	L452 10UH 2520
---------	---------------------	----------------------

Kinds of capacitor	External dimensions (mm)
Case size	

- Constants of resistors, capacitors, ICs and etc with XX indicate that they are not used.
In such cases, the unused circuits may be indicated.
- Parts with ★ differ according to the model/destination. Refer to the mount table for each function.
- All variable and adjustable resistors have characteristic curve B, unless otherwise noted.
- Signal name
XEDIT → EDIT PB/XREC → PB/REC
- : non flammable resistor
- : fusible resistor
- : panel designation
- : B+ Line
- : B- Line
- : IN/OUT direction of (+, -) B LINE.
- : adjustment for repair.

Precautions for Replacement of Imager

- If the imager has been replaced, carry out all the adjustments for the camera section.
- As the imager may be damaged by static electricity from its structure, handle it carefully like for the MOS IC.
In addition, ensure that the receiver is not covered with dusts nor exposed to strong light.

When indicating parts by reference number, please include the board name.

The components identified by mark Δ or dotted line with mark Δ are critical for safety.
Replace only with part number specified.

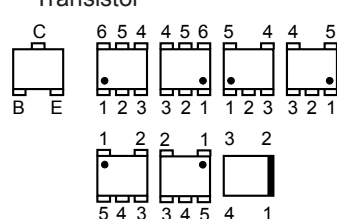
Les composants identifiés par une marque Δ sont critiques pour la sécurité.
Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.

For Printed Wiring Boards

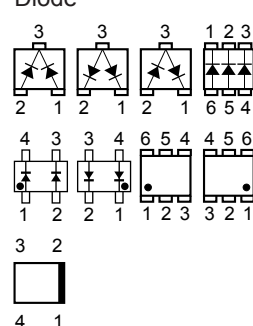
- : Uses unleaded solder.
- : Circuit board
- : Flexible board
- Pattern from the side which enables seeing.
- : pattern of the rear side
(The other layers' patterns are not indicated)
- Through hole is omitted.
- There are a few cases that the part printed on diagram isn't mounted in this model.
- : panel designation

Chip parts.

Transistor



Diode



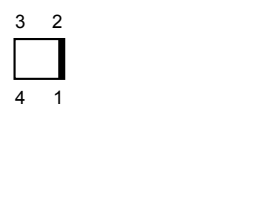
Chip parts.

Transistor



Chip parts.

Diode



- JAPANESE -

回路図, プリント図共通ノート
(他に必要なノートは各セクションに記載しています)

回路図ノート

- ケミコン, タンタルを除くコンデンサで, 耐圧50V以下のものはその耐圧を省略。単位はすべて μF (pは pF)。
- チップ抵抗で指示のないものは, 1/10W以下。
 $\text{k}\Omega=1000\Omega$, $\text{M}\Omega=1000\text{k}\Omega$
- チップ部品交換時の注意
取り外した部品は再使用せず, 未使用の部品をご使用ください。
タンタルコンデンサのマイナス側は熱に弱いので注意してください。
- チップ部品には下記のように表示したものがああります。

例	C541 22U TA A	L452 10UH 2520
種類	ケースサイズ	外形寸法 (mm)

- 抵抗, コンデンサ, ICなど定数にXXがあるものは, 使用していない事を示しています。このため, 使用していない回路が記載されている事があります。
- ★印のある部品は, 機種などにより異なりますので機能別マウント一覧表を参照してください。
- 可変抵抗と半固定抵抗で, B特性の表示を省略。
- 信号名表記について, 下記のような場合があります。
XEDIT → EDIT PB/XREC → PB/REC
- は不燃性抵抗。
- はヒューズ抵抗。
- はパネル表示名称。
- はB+ライン。
- はB-ライン。
- はBライン(+, -)の入出力方向を示す。
- は調整名称。

イメージ交換時の注意

- イメージを交換した場合は, カメラ部の全調整を行ってください。
- イメージは構造上, 静電気により破壊される恐れがあるため, MOS ICと同様に注意して取り扱ってください。
また, 受光部にはゴミの付着, および強い光がはいることのないように注意してください。

— お願 —

図面番号で部品を指定するときは基板名又はブロックを併せて指定してください。

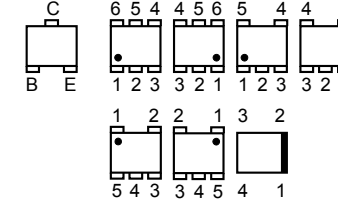
Δ 印の部品, または Δ 印付の点線で囲まれた部品は, 安全性を維持するために, 重要な部品です。
従って交換時は, 必ず指定の部品を使用してください。

プリント図ノート

- : 無鉛半田を使用しています。
- : 基板
- : フレキシブル配線板
- 見ている面側のパターン。
- : 裏側のパターン
(他のパターンについては表示されていません)
- スルーホールは省略。
- プリント図には, 本機で使用していない部品が記載されている場合があります。
- はパネル表示名称。

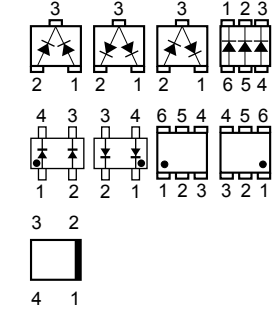
Chip parts.

Transistor

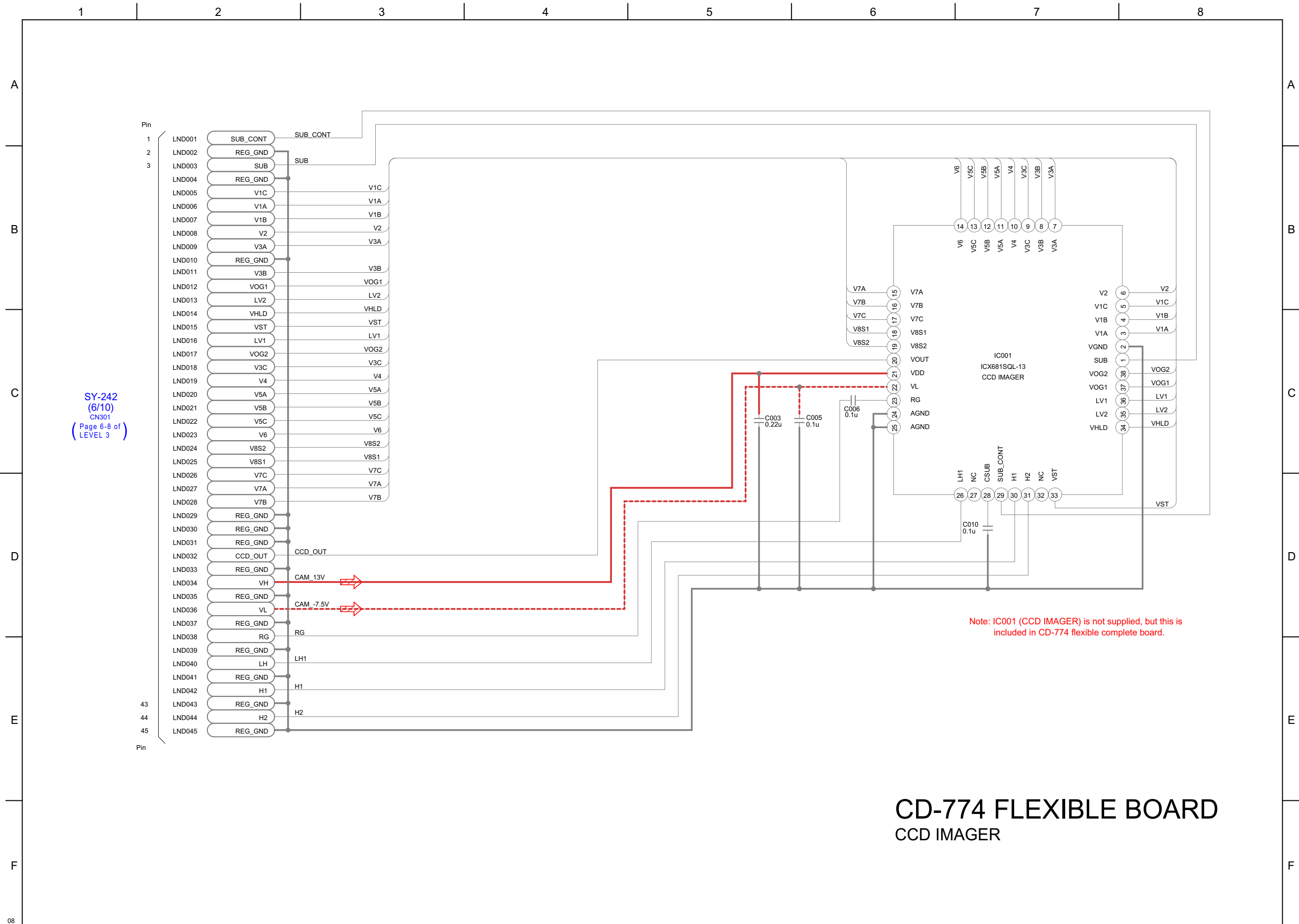


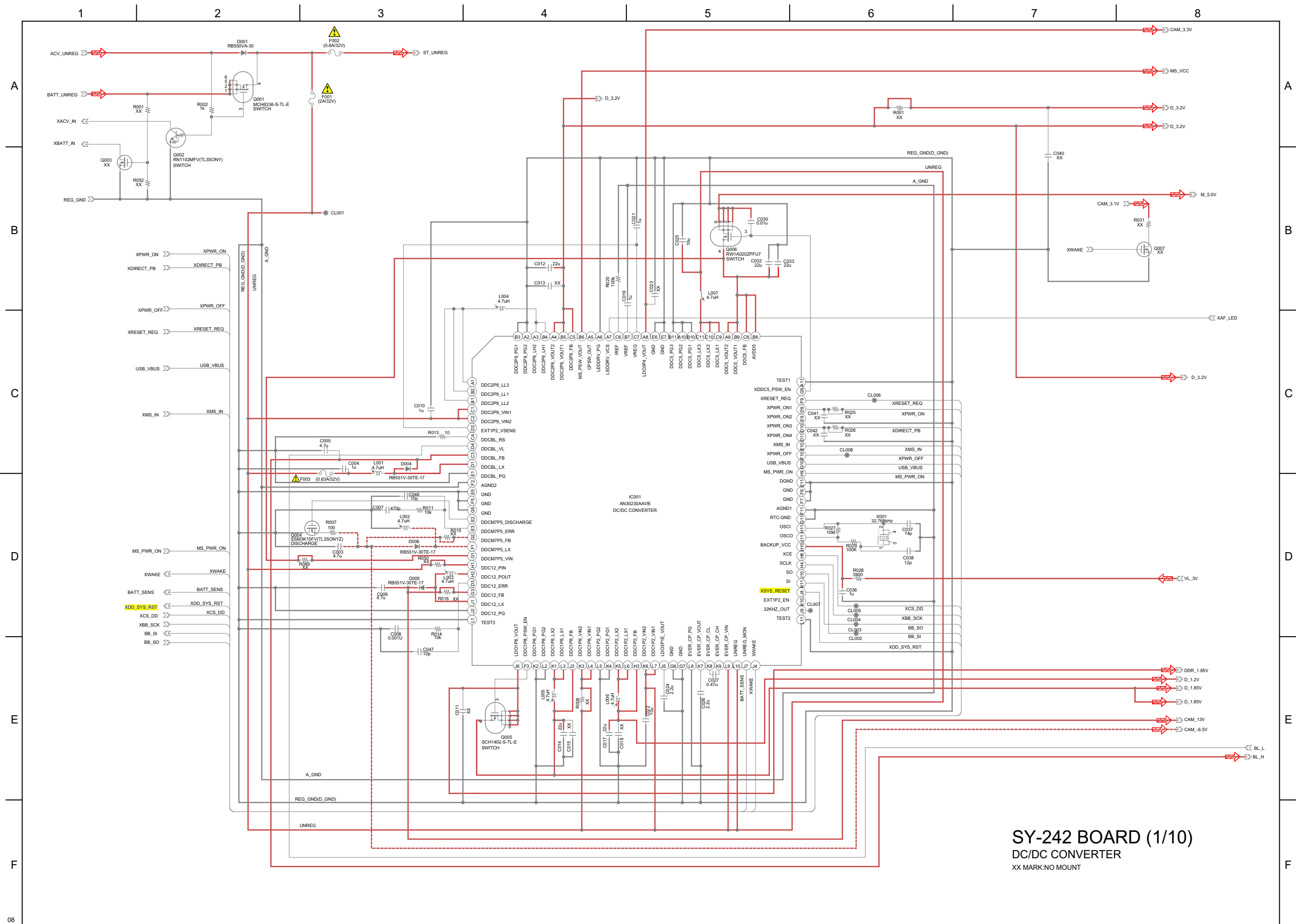
Chip parts.

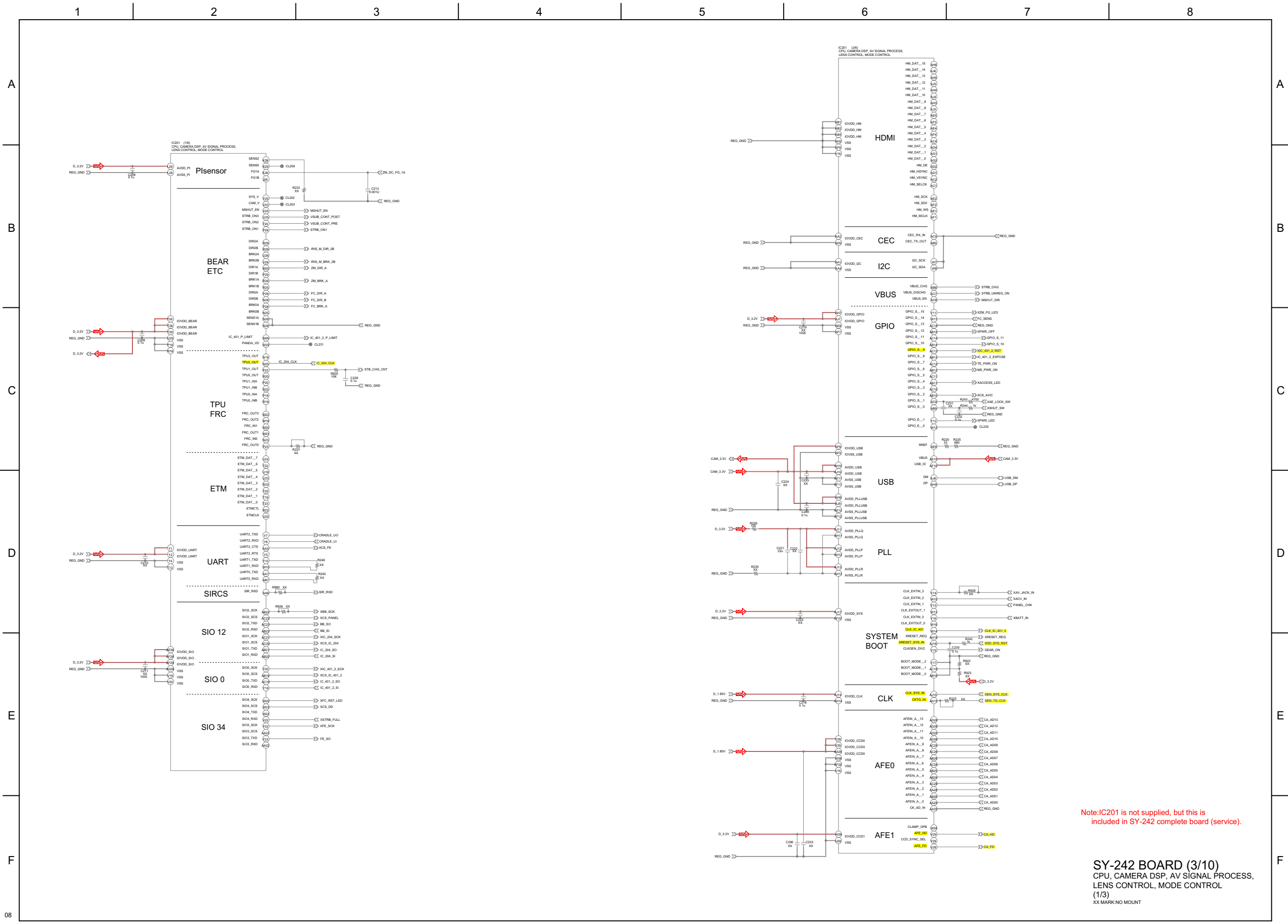
Diode



6-1. SCHEMATIC DIAGRAMS

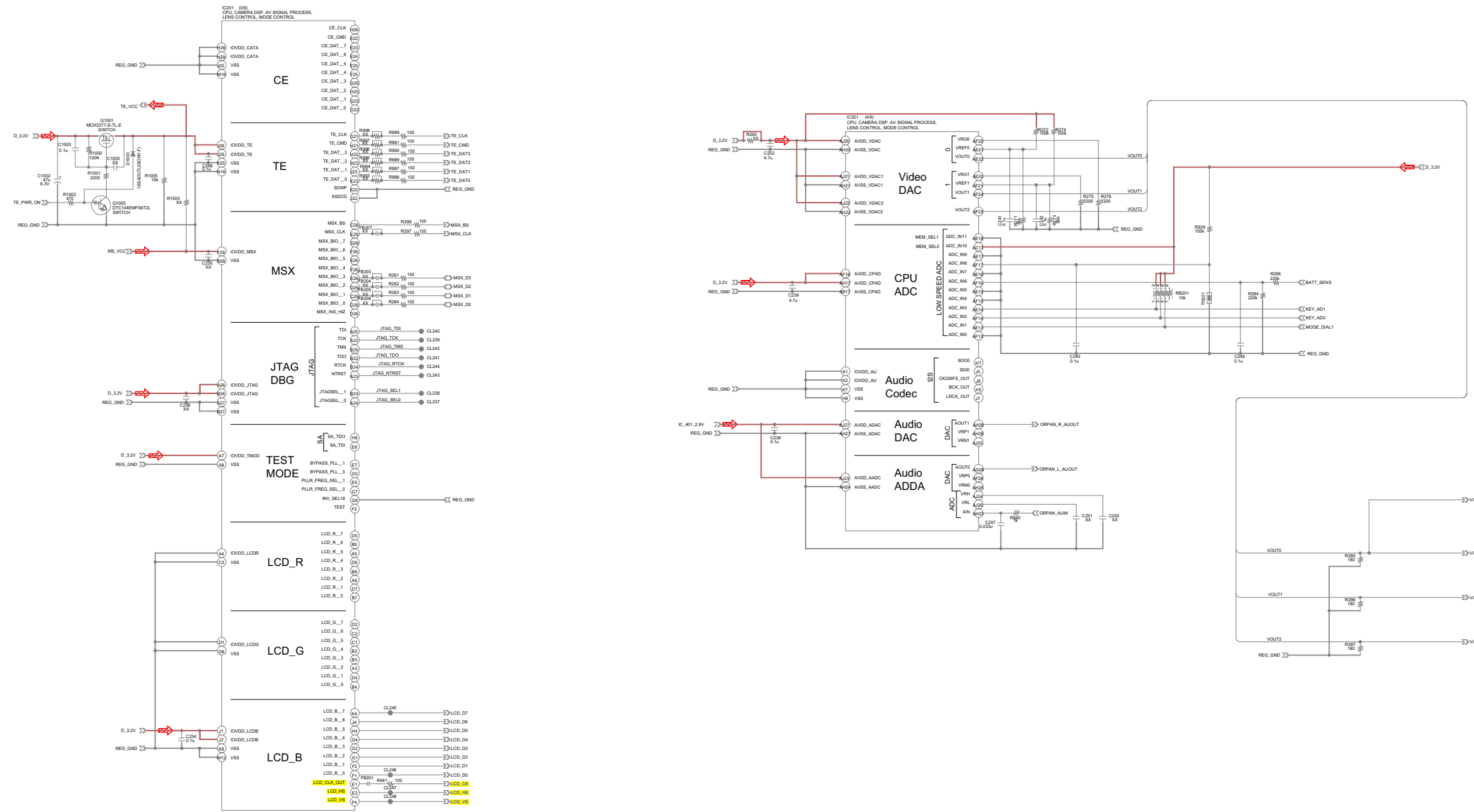






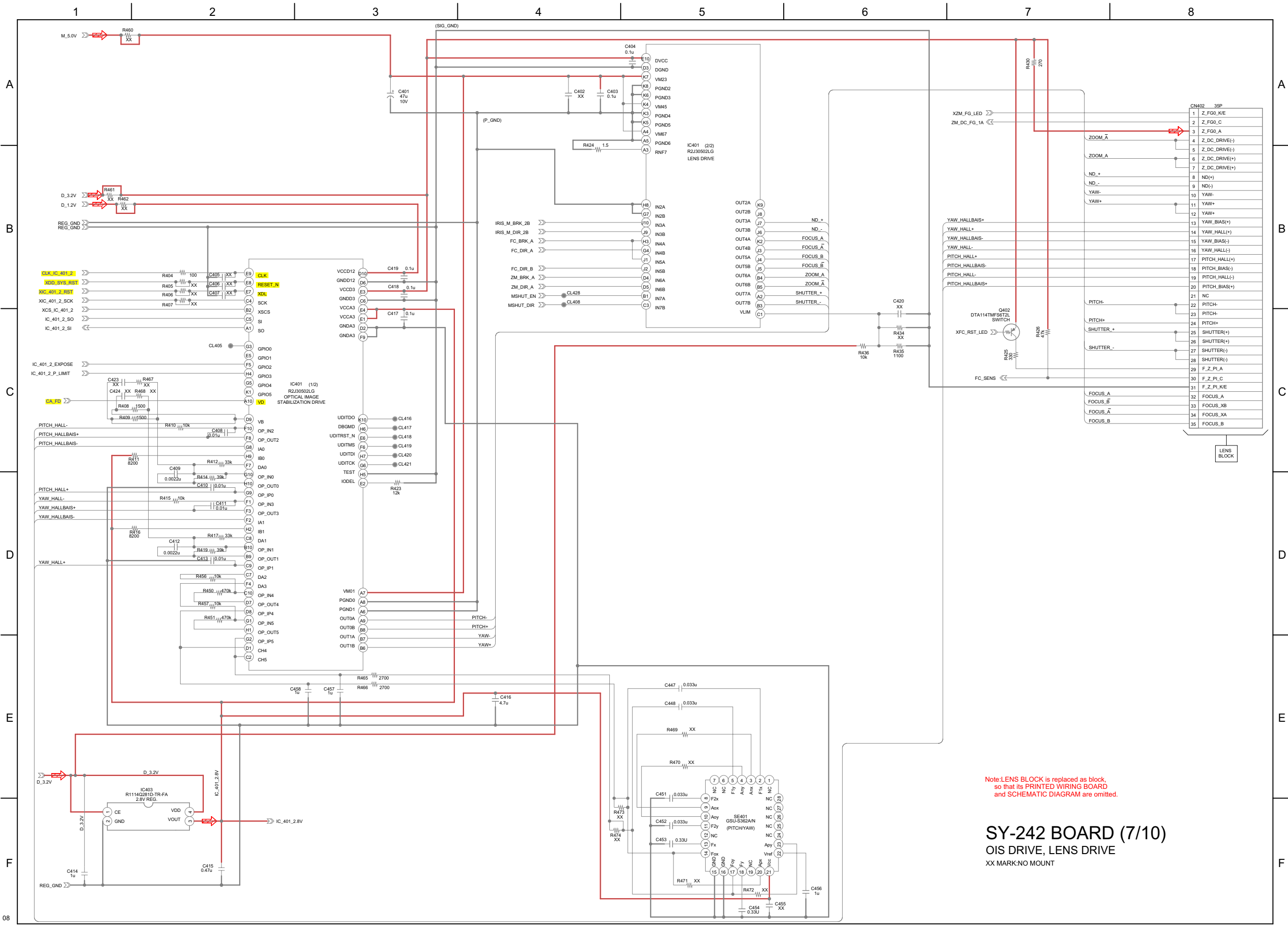
Note: IC201 is not supplied, but this is included in SY-242 complete board (service).

SY-242 BOARD (3/10)
 CPU, CAMERA DSP, AV SIGNAL PROCESS,
 LENS CONTROL, MODE CONTROL
 (1/3)
 XX MARK:NO MOUNT



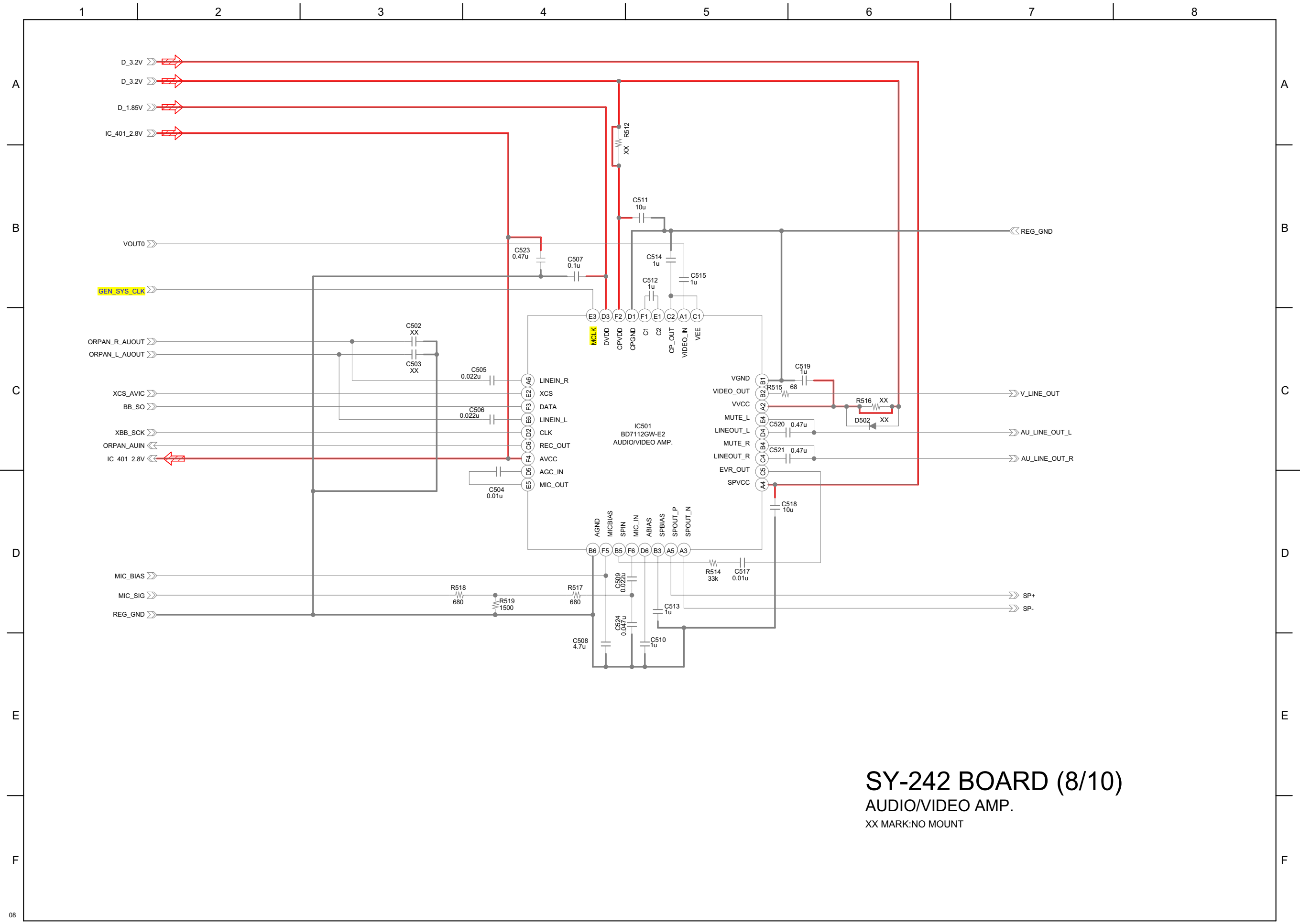
Note:IC201 is not supplied, but this is included in SY-242 complete board (service).

SY-242 BOARD (4/10)
CPU, CAMERA DSP, AV SIGNAL PROCESS,
LENS CONTROL, MODE CONTROL
(2/3)
XX MARK:NO MOUNT

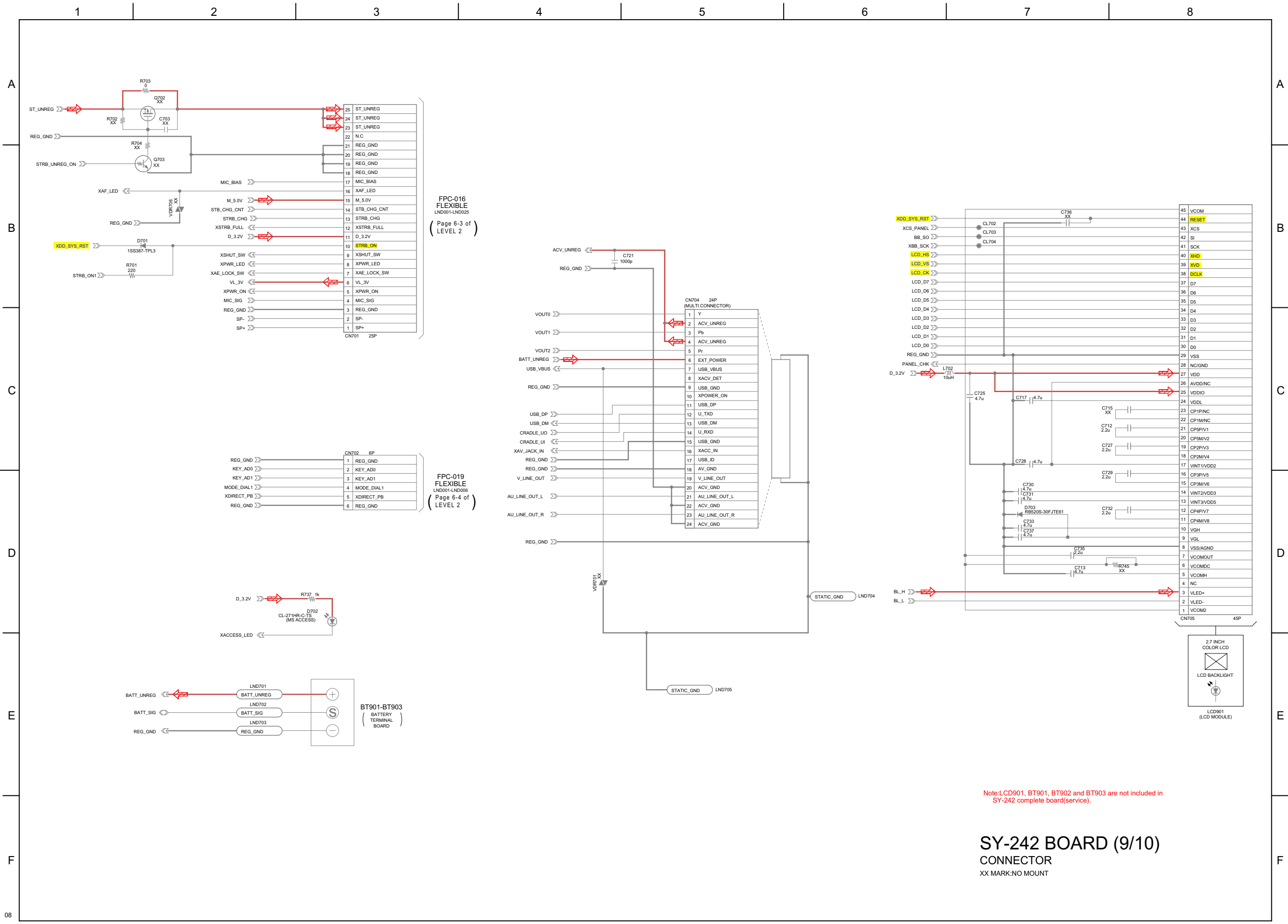


Note: LENS BLOCK is replaced as block, so that its PRINTED WIRING BOARD and SCHEMATIC DIAGRAM are omitted.

SY-242 BOARD (7/10)
 OIS DRIVE, LENS DRIVE
 XX MARK:NO MOUNT

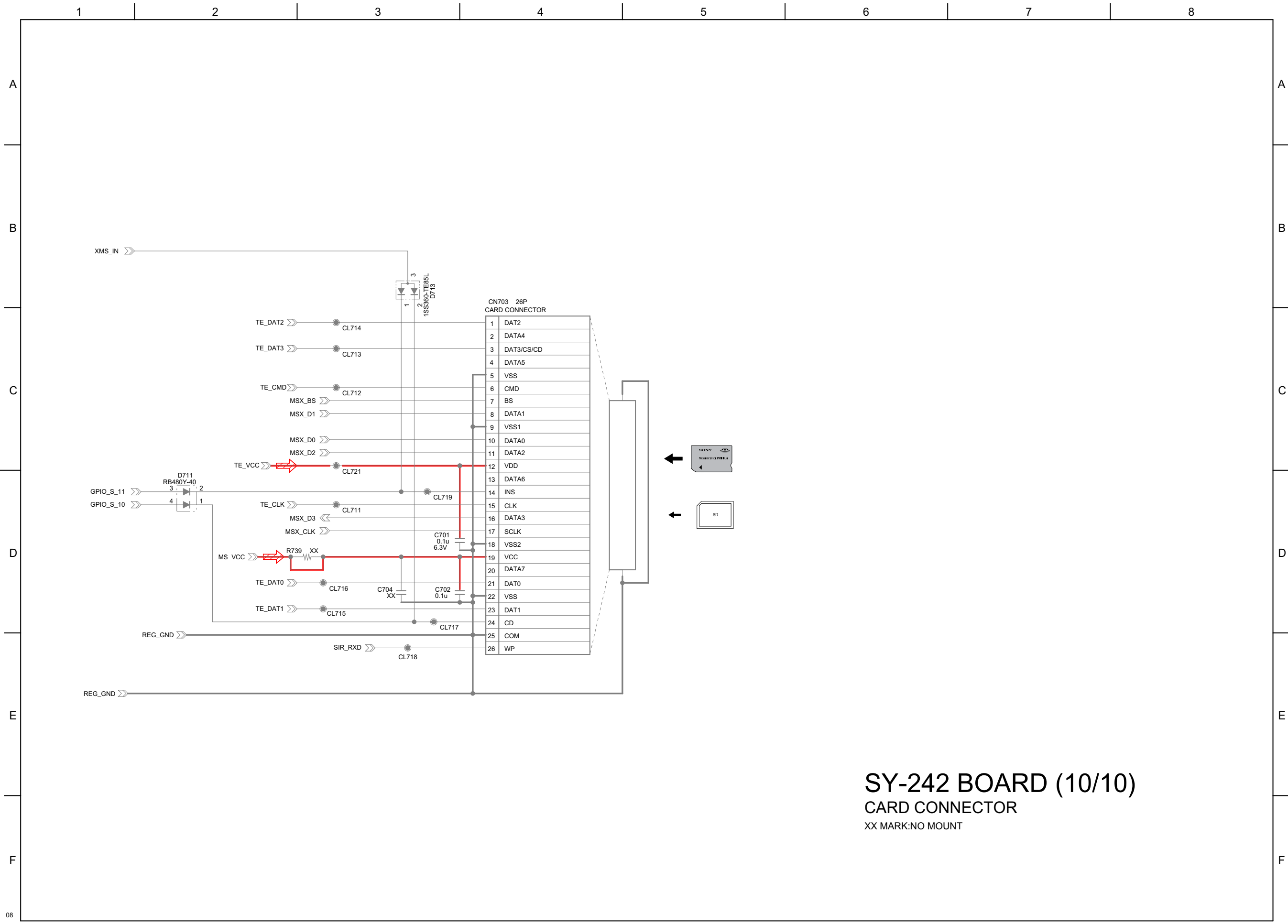


SY-242 BOARD (8/10)
AUDIO/VIDEO AMP.
 XX MARK:NO MOUNT



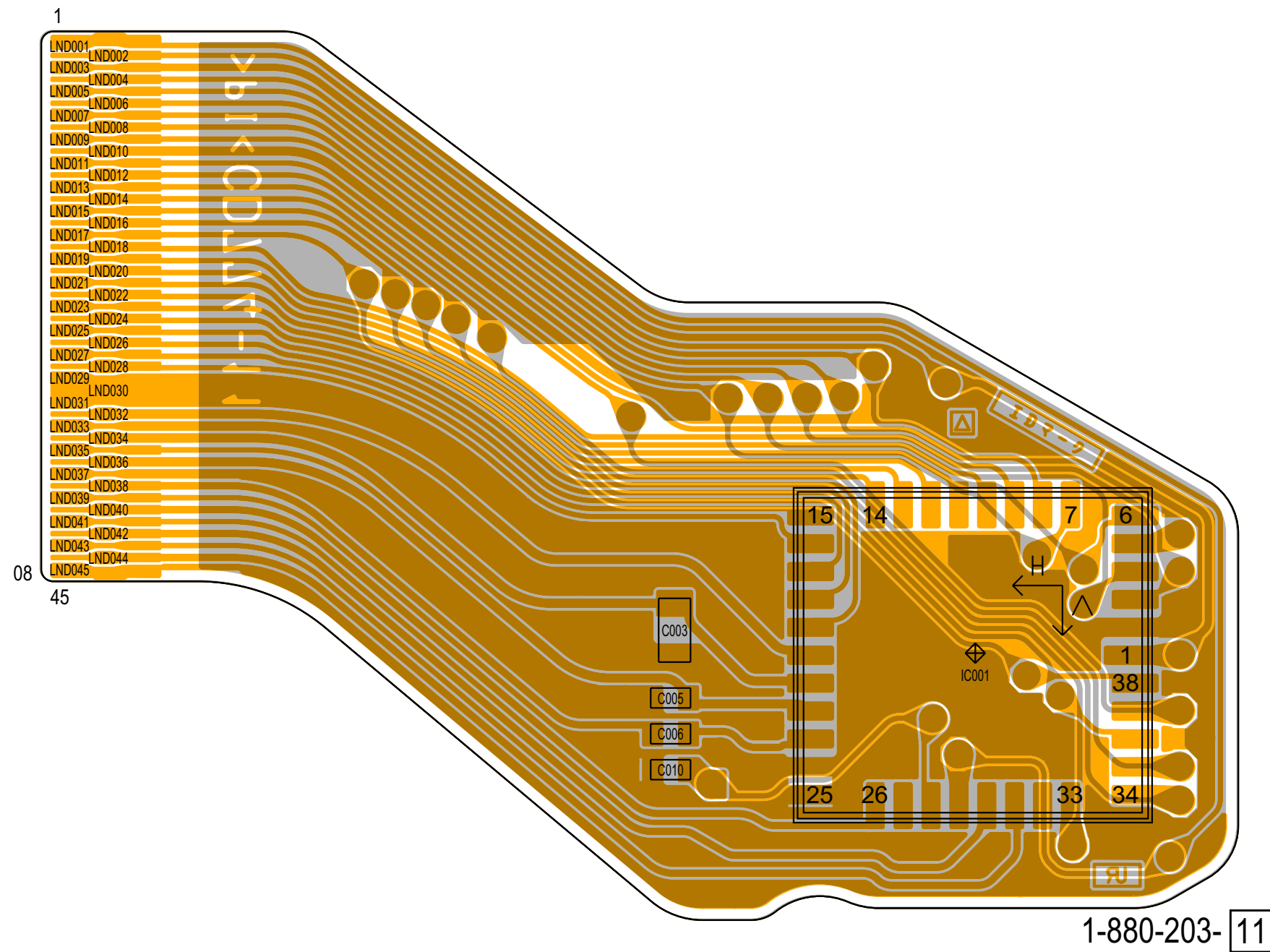
Note: LCD901, BT901, BT902 and BT903 are not included in SY-242 complete board(service).

SY-242 BOARD (9/10) CONNECTOR
XX MARK:NO MOUNT



SY-242 BOARD (10/10)
CARD CONNECTOR
 XX MARK:NO MOUNT

CD-774 FLEXIBLE BOARD



Note: IC001 (CCD IMAGER) is not supplied,
but this is included in CD-774 flexible complete board.

